

公益社団法人 日本技術士会の登録グループ
技術士包装物流グループ主催の研究会のお知らせ

当グループは、包装(パッケージ)と物流(ロジスティクス)を専門とするコンサルタントで構成された集団(略称 JPLCS)です。包装設計や包装試験・評価・改善、物流の戦略策定や輸配送システム・MH システムの改善、ISO 対応等皆様のニーズに最も適したコンサルティングを致します。

＜ 技術士包装物流会の研究会の予告 ＞

「東京」

日時：平成 28 年 11 月 21 日 (月) ----- 18:00～20:00

場所：日本技術士会会議室

〒手第二ビル5階 ((フキデダイニビル) 東京：田中山ビルの隣)

講演：高温高圧調理ができる電子レンジ対応袋とその効果

講師：株式会社メイワパックス 野田技術開発課 平田達也

技術士(経営工学ロジスティクス)、包装専士(包装材料)

内容：近年、電子レンジ対応袋を用いた冷凍食品が増えているが、その開発において、「加熱ムラ」「加熱時間短縮」に苦心されている食品メーカーは多い。加熱ムラ対策や加熱時間短縮の方法として、食材のサイズや充填レイアウトの工夫が挙げられるが、袋内に発生する「蒸気」のエネルギーを有効利用する方法もある。今回、袋内を高温高圧環境に維持する脱蒸弁を設けた電子レンジ対応袋「レンジでポンスリットタイプ」の説明とその効果について説明する。

会費：当グループ会員以外の方は、参加費 2,000 円

申し込み先：研究会担当：住本、sumi1901@jcom.home.ne.jp

一般企業の方、会員外の研究会ご参加も歓迎です、どうぞお気軽にお申込み下さい。

なお、当日は、研究会終了後、同じ場所で講師を囲んで懇親会を開催致します。ぜひご参加ください。会費は、1000 円くらいです。

「技術士包装物流グループ」(略称 JPLCS)の活動内容・お問い合わせ

<http://www.jplcs.com/>

をご参照ください。

